

Zwei neue UV-Lasersysteme von LPKF Höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit mit LPKF MicroLine 2000-Systemen

Ansprechpartner:

Malte Borges
malte.borges@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF

Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand

Dr. Ingo Bretthauer
(Vorsitzender/CEO)

Bernd Lange (CTO)

Kai Bentz (CFO)

Dr. Christian Bieniek (COO)

Aktie:

TecDAX
Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» **Weitere Pressemeldungen**

Garbsen, November 2014. Die beiden neuen UV-Lasersysteme LPKF **MicroLine 2000 P** und **MicroLine 2000 S** erweitern die Palette der **UV-Schneidlaser**. Die **MicroLine 2000 P** ist für das Schneiden flexibler Leiterplatten und Coverlayer entwickelt. Die **MicroLine 2000 S** trennt bestückte Leiterplatten aus größeren Nutzen – stressfrei und mit minimalen Schneidbreiten. Beide Systeme sind mit unterschiedlichen Laserquellen verfügbar und stehen für hohe Präzision, flexible Produktion und Wirtschaftlichkeit.

Die innovativen MicroLine-Systeme von LPKF dienen zum Trennen starrer, starr-flexibler und flexibler Schaltungsträger oder Coverlayern. Sie empfehlen sich besonders für komplexe Formen, denn der UV-Laser schneidet beliebige Konturen mit minimalen Toleranzen direkt aus den Layout-Daten. Darüber hinaus überzeugen die Systeme durch nahezu grat- oder partikelfreie Schnitte. Auch empfindliches Material bleibt mechanisch und thermisch nahezu unbeeinträchtigt.

Flache Substrate, mehr Nutzen auf Basismaterial

Sollen flache Materialien bearbeitet werden, z.B. bei komplexen Elektronikbaugruppen, reduziert der LPKF MicroLine 2000 P bei jedem neuen Layout die Vorlaufzeit und Werkzeugkosten. Die Substrate werden von einem Vakuumentisch sicher gehalten. Dies gilt für das Trennen/Schneiden dünner flexibler Substrate (Coverlayer, flexible PCBs), Schneiden von Löchern in flexible oder dünne starre Leiterplatten, Separieren flexibler Bereiche bei Starr-flex-Layouts sowie Erzeugen von Taschen im Substrat. Dabei steht die Präzision im Vordergrund: Beim Schneiden lässt sich der UV-Laser präzise mit genau definiertem Materialabtrag steuern, insbesondere auch bei Tiefenlagen oder zum Säubern von Kupferlagen.

Das UV-Laserschneiden benötigt kaum Platz für die Schnittkanäle und führt zu mehr Leiterplattennutzen auf dem Basismaterial. Substrate werden in unmittelbarer Nähe zu empfindlichen Bauteilen oder Leiterbahnen sicher getrennt. Die Vorteile: höhere Bestückungsdichte bis an den Rand der Leiterplatte, niedrigere Ausschussrate.

Doppelte Laserpower

Beide Systeme, MicroLine 2000 P und MicroLine 2000 S, sind mit unter-

schiedlichen Laserquellen verfügbar. Der 6W-Laseroutput erlaubt das Schneiden von Leiterplatten bis ca. 0,8 mm Stärke. Der 12W-Output eignet sich besonders zum Trennen starrer Leiterplatten, schnelleres Schneiden dünner Substrate und wirtschaftliches Bearbeiten von Substraten bis 1,6 mm Stärke.

Einfache Bedienung, flexible Produktion

Mittels CAM-Software lassen sich die Layoutdaten aus CAD-Programmen übernehmen und schnell für gewünschte Bearbeitungsprozesse optimieren. LPKF CircuitMaster ist auf hohe Prozessgeschwindigkeit und intuitive Bedienung optimiert. Die Software kann für eine einfache Produktion auf Knopfdruck oder den vollständigen Zugriff auf die Prozessparameter konfiguriert werden.

Die MicroLine-2000 Systeme sind auch aufgrund geringer Investitions-, Betriebs- und reduzierter Werkzeugkosten eine Option. Weitere Vorteile: Kurze Umrüstzeiten, ein niedriger Energieverbrauch, hohe Maschinenverfügbarkeit sowie geringen Stückkosten sprechen für die neuen UV-Laser von LPKF.



Neue UV-Laserschneidsysteme LPKF MicroLine2000 auf der electronica in München.

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.